

More-than-Moore Litho/Bonding Market to \$2.8 Billion in 2027, Yole Forecast – September 11, 2022

More-than-Moore向けリソ/ボンディング市場は2027年に28億ドルに、Yole予測

9月12日（月）13時27分 [マイナビニュース](#)

市場調査会社の仏Yole Groupは、More-than-Moore向け2大装置市場であるリソグラフィとボンディング市場は、2020年に合計で17億ドル規模であったものが、2027年に向けて年平均成長率(CAGR)8%で成長し、2027年には28億ドルに達するとの予測を公開した。

内訳としてはMore-than-Moore向けリソグラフィ(i-line/DUV)は、2020年には13億ドル規模であったが、CAGR5%で伸び、2027年には19億ドルに達するという。一方のボンディング市場の中で、一番規模の小さなD2W(ダイ・ツー・ウェハ)ハイブリッドボンディング市場は、2020年に600万ドル規模であったが、先端半導体各社が採用を進めていることもあり、CAGR69%で伸び、2027年には2.3億ドル規模に成長する。また、W2W(ウェハ・ツー・ウェハ)ボンディングはCAGR16%で、2027年に5億ドル規模まで成長するとしている。W2Wテクノロジーは、3Dスタッキング、CMOSイメージセンサ、3D NAND、AIプロセッサ、MEMSなどの基板の統合に使用されるという。また、テンポラリーボンディング(仮接合)は、CAGR7%で伸び、2027年には1.8

More-than-Mooreデバイスを製品カテゴリ別に見ると、最大市場はパワーIC/パワーディスクリーターだが、そのCAGRは4%程度と高くなく、2027年の市場規模は8800万ドルと予測されている。2020年は、次いで先進パッケージ、光学デバイス、RFデバイス、MEMSデバイス、CMOSイメージセンサ、各種基板材料という順になっており、2027年になっても大きな変化は生じないと見られるという。

こうした各市場を支えるMore-than-Moore用リソグラフィおよびボンディング装置プロバイダとしては、東京エレクトロン(TEL)がW2Wボンディングと仮接合・剥離向け装置を供給しているほか、キヤノンがリソグラフィとW2Wボンディングの両方の装置を供給している点が注目されるという。それ以外の主要なMore-than-Moore製造装置メーカーの動向は以下の通り。

キヤノンはMore-than-Mooreリソグラフィ市場のリーダーであるが、ASMLが追い上げてきている。

EV Group(EVG)は、W2Wパーマネントボンディングとテンポラリーボンディングのマーケットリーダーであり、W2Wパーマネントボンディング事業では、EVGの後にTELが続いている。

関連記事が外部リンク(仮接合・剥離)は、トップのEVGにSUSS MicroTecが続いている。

D2Wハイブリッドボンディング分野では、Besi、芝浦メカトロニクス、Smart Equipment

- More-than-Moore向けエピ成長装置市場、2026年には11億ドル規模に - Yole予測
- ムーアの法則の向こう側 - More than Mooreはどこに向かうのか？
- 半導体の技術的な「進歩」を支えてきた「スケーリング」
- 高い伸びが期待されるMore than Moore用ウェハ需要 - Yole
- FOWLPLの進化を支える電解めっき技術

https://news.biglobe.ne.jp/it/0912/mnn_220912_3472570737.html